

# 표면의 성능 특성을 향상시킬 수 있는 전자빔/이온빔 피니싱 장치

기술분류 광응용기기

거래유형 라이선스

기술가격 별도 협의

기술구분 패키징 기술

## 기술개요

본 기술은 **전자빔 및 이온빔을 이용한 피니싱 장치**이다. 본 기술에 따르면, 전자빔을 피처리물에 조사하고, 효율 향상을 위해 이온빔을 조사시키면, **전자빔에 의해 형성된 열에너지를 통해 표면을 피니싱 처리하며, 더불어 기계적 또는 수작업에 의한 피니싱 공정에 소요되는 시간을 단축시킬 수 있다.** 본 피니싱 장치는 **친환경적인 기술로 화학적 유해 물질을 사용하지 않고 피처리물의 표면 성능을 향상시킬 수 있어 기존 제품 대비 활용 가치가 높다.**

## 기술개발배경

표면 피니싱 공정 시 오염 물질을 배출하지 않고, 표면의 조도나 디버링 특성을 향상시키기위함

## 기존기술 한계

- 기계적인 폴리싱 및 디버링 공정의 경우 수반되는 폐액 처리와 공정 후 추가 후처리 공정의 필요 및 기계적 피니싱의 낮은 효율과 자동화의 어려움
- 전해 피니싱 공정의 경우 강산액체의 사용으로 인한 폐액 처리 및 클리닝 문제가 발생할 가능성이 높음

## 개발기술 특성

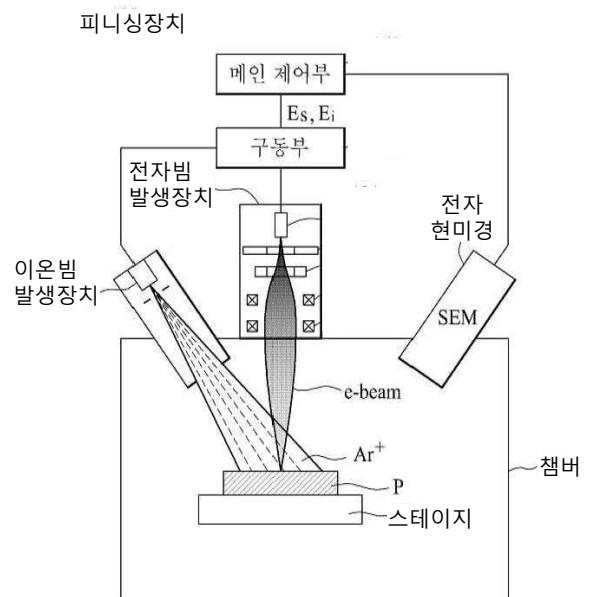
- 피처리물의 표면을 최적 조건으로 표면 피니싱 처리함으로써 단 시간 내에 표면 개질 특성을 향상시킬 수 있음
- 공정 단축 및 표면 피니싱의 자동화가 가능하여 생산 수율을 향상시킬 수 있으며, 별도의 강산 액체를 사용하지 않아 친환경적임

## 기술구현

본 피니싱 장치의 구성은 아래와 같다.

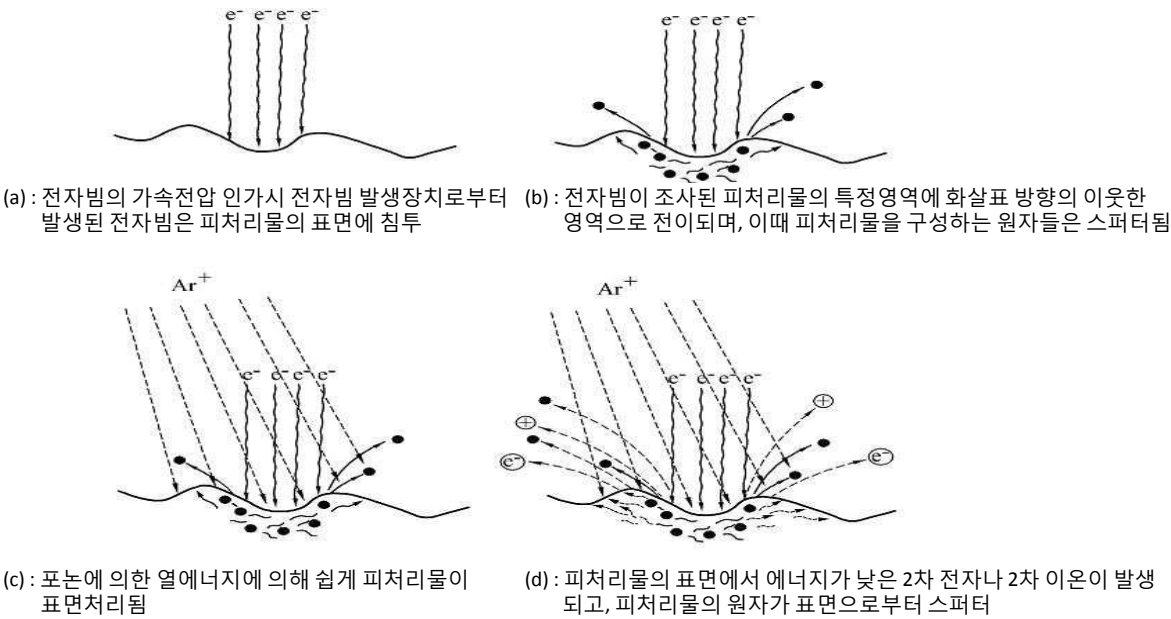
- 스테이지 : 피처리물 배치
- 챔버 : 스테이지를 감싸며 내부 진공상태를 유지
- 전자빔 발생장치 : 챔버 상부에 배치되어 피처리 물에 전자빔을 조사
- 이온빔 발생장치 : 전자빔이 조사되는 피처리물에 이온빔을 조사하여 표면처리
- 전자현미경 : 피처리물의 표면 조도값을 측정하기 위해 챔버 상부에 배치

[본 피니싱 장치의 구성 예]



주요도면, 사진

[본 피니싱 공정의 매커니즘 예시]



기술완성도



시작품 제작 및 성능 평가

기술활용분야

일반 기계 부품 및 정밀 기계 부품의 표면 가공 분야(소재합성, 건식, 습식, 세정)

시장동향

- 새로운 개념의 상품 등장으로 인해 수요층이 다양화 될 것으로 보이며, 특히 건식코팅 시장의 경우, 환경규제 여파로 인해 기존 시장 대비 10배 이상씩 급 성장할 것으로 예상
- 세계 표면처리 시장은 2007년 143조 원에서, 2015년 357조 원의 규모를 형성할 것으로 보이며, 국내 시장의 경우는 세계 시장의 약 2% 수준인 약 7조 원 규모가 될 것으로 전망

지식재산권 현황

No.	특허명	출원일자	등록번호	IPC
1	전자빔 및 이온빔을 이용한 피니싱 장치 및 방법	2011.10.21	10-1156184	C21D 1/09
2	전자빔 방출장치의 전자빔 팁과 렌즈 및 렌즈와 렌즈간의 정렬구조 및 정렬방법	2010.05.14	10-1123631	H01J 37/067
3	사각형상 전자빔 방출유닛을 구비한 소형전자빔 장치	2010.05.14	10-1156179	H01L 21/027
4	진공유지 및 실시간 열라인이 가능한 소형 전자빔 장치	2010.05.14	10-1156180	H01J 37/067